



2025 年 8 月 20 日

各 位

高周波基板用電解銅箔「VSP™」の生産体制追加増強

～ 台湾・マレーシア両工場の追加増強により 45%増加の 840t/月体制に ～

当社（社長 納 武士）は、現在台湾工場（台湾銅箔股份有限公司）およびマレーシア工場（Mitsui Copper Foil (Malaysia) Sdn Bhd）にて製造している高周波基板用銅箔「VSP™」の生産体制について、両工場での生産能力追加増強により、2025 年 1 月 7 日ニュースリリース「高周波基板用電解銅箔「VSP™」の生産体制増強」にて公表しました 580t/月体制から、2026 年 9 月までに 45%増の 840t/月体制とすることをお知らせいたします。

当社の高周波基板用電解銅箔「VSP™」は、高周波数帯におけるプリント基板の伝送損失低減に大きく寄与することから、サーバー、ルーター、スイッチ等の高性能通信インフラ機器に採用されております。足元は、AI インフラ関連、特に HVLP5 グレード品が開発から量産フェーズに移行するなど、当社の VSP™ の需要が当初の計画以上に加速度的に増加しており、今後も更なる拡大が期待されます。

このような状況を受け、2025 年 1 月 7 日公表の 420t/月体制から 580t/月体制の増強に加え、台湾工場にて現有設備でのさらなる生産性改善を進めた結果、両工場合算で 420t/月から 620t/月への増強を完了いたしました。また、今後は両工場において現有設備の転用等による追加増強を段階的に図り、2026 年 3 月までに生産能力 720t/月、9 月までに 840t/月体制へ増強いたします。

これらの施策により生産能力は増加いたしますが、今後もさらなる需要拡大に応じた増強も視野に入れ、旺盛な需要に十分対応してまいります。

当社は、パーパスである「探索精神と多様な技術の融合で、地球を笑顔にする。」を基軸に、2030 年のありたい姿である全社ビジョン「マテリアルの知恵で “未来” に貢献する、事業創発カンパニー。」を実現することで、サステナブル（持続可能）な社会作りに貢献してまいります。

■VSP™生産能力（ご参考）

単位：t/月	増強前	25年8月現在	2026年3月	2026年9月
台湾工場	420	560	600	720
マレーシア工場	0	60	120	120
計	420	620	720	840

以 上

【お問い合わせ先】

三井金属 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

TEL : 03-5437-8028 E-mail : PR@mitsui-kinzoku.com



一般銅箔



VSP™

写真 アップルマンゴーが映り込んだ銅箔の表面

※VSP™は、鏡面のような優れた表面平滑性が特徴

（ご参考）

VSP™の主な用途：

通信インフラ機器（サーバー、スイッチ、ルーター、基地局など）などの高周波基板用銅箔